

# MOCVD 原料の FTIR によるガスフェーズ計測

# Gas Phase Analysis of MOCVD Materials by FTIR

佐竹 司



## 要旨

強誘電体材料が薄膜化され,半導体デバイス(FRAM)として実用化されようとしている。薄膜の材料と製法は各種提案されているが,本研究では,とくにMOCVD成膜法とPZT原料に注目した。MOCVD装置に供給される鉛, チタン,ジルコンの3種類の原料の気相状態をホリバの FTIRガス分析計 FT-730で計測したところ,気化・混合部ですでに中間体を形成していることを確認した。これらの結果から,MOCVD装置の原料供給系を含むFRAMの研究開発や生産プロセスにおいて,FTIRが大変有用な ツールとなるものと期待される。

## Abstract

The ferroelectric thin film is going to be put to practical use as a semiconductor memory device of the next generation. Although various kinds of material and deposition technique for this film are proposed now, the optimum deposition conditions are not yet established. Then we have measured infrared spectrum of three gases that was supplied as souse materials for MOCVD using Horiba's gas analyzer, the FT-730. And we have found that some intermediate products is formed in evaporation / mixture chamber. It is expected that FTIR is a very useful tool in the research laboratory or the production process of FRAM.

## 1 はじめに

フーリエ分光法の基本的な原理上の優位性は1950年頃 に提唱された<sup>1)</sup>。その後,ガスレーザの開発や高速フーリ エ変換(FFT)のアルゴリズム開発など基盤技術の進化とと もにFTIR は進歩してきた。なかでも,1980年代に汎用化 したのは,とくにマイクロコンピュータの低価格化と高速 化に負うところが大きく,まさに半導体技術の進展に支え られて,FTIR 測定器が容易に利用できるようになったと 言っても過言ではない。

強誘電体メモリ(FRAM)は,半導体素子の高速動作および 大規模処理を支えるデバイスとして研究開発が進んでおり, 現在では生産技術面の検討がなされている。強誘電体薄膜の 成膜手法としては,ゾルゲル法,スパッタ法など各種あるが, 本研究では,高速成膜に向いている有機金属原料を使った化 学的気相成長法(MOCVD)に着目し,FTIRにより薄膜用原 料の気相状態の計測を試みた結果を報告する<sup>2</sup>)。

通常,MOCVD法による成膜用原料は液体または固体であ り,CVDチャンバーへは気化した後に供給される。そこで, FTIRにより原料ガスの状態をモニタし,原料供給の制御系 にフィードバックすることにより成膜技術の開発や半導体 生産プロセスの安定化に貢献することを目指している。

# 2 測定対象

図1に,MOCVD法による成膜装置と原料供給系の一例 を示す。図では,チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)の成膜を行 う例を示している。薄膜原料はそれぞれ原料ボトルに充填 し,成膜プロセスに最適な蒸気圧を得る温度に恒温化され る。原料はアルゴンなどのキャリアガスによりそれぞれ気 化・混合部に圧送され,ここでガス化し混合されて,最終 段で酸素を添加しCVDチャンバーへ送られる。FTIR は図 中に示したように,気化・混合部内の計測を行う。

FRAM用の原料の例を表1に示す。原料は製膜技術の進展とともに改良,あるいは開発がなされている。



図1 MOCVD法による製膜システム例

	Chemical Formula	Melting point°C	Properties
For PZT	Pb (C <sub>11</sub> H <sub>19</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	130	white/solid
	Zr (O⋅t-C₄H <sub>9</sub> )₄	3	light brown/liquid
	Ti (O·i-C₃H <sub>7</sub> )₄	20	colorless/liquid
	Ti (O∙i-C₄H <sub>9</sub> )₄	4	lightbrown /liquid
	$Ti(O \cdot i - C_3H_7)_4(C_{11}H_{19}O_2)_2$	160	light yellow/solid
For SBT	Sr (C <sub>11</sub> H <sub>19</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	210	white/solid
SBTN	Bi (O⋅t-C₄H <sub>9</sub> ) <sub>3</sub>	150	white/solid
	Bi (O·t-C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> ) <sub>3</sub>	90	white/solid
	Bi (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>3</sub>	80	white/solid
	Ta (OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>5</sub>	21	colorless/solid · liquid
	Ta (O⋅i-C₃H <sub>7</sub> )₅	107	white/solid
	Nb (OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>5</sub>	6	amber/liquid
	Nb (O·i-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>5</sub>	5	white/solid
	$Sr[Ta(OC_2H_5)_6]_2$	130	white/solid
	Sr[Ta(O·i-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>6</sub> ] <sub>2</sub>	256	white/solid
	$Sr[Nb(OC_2H_5)_6]_2$	120	white/solid
	$Sr[Nb(O \cdot i - C_3H_7)_6]_2$	250	white/solid

表1 MOCVD 用原料の例

## 3 ガス測定試験

PZT の成膜条件を想定し,ホリバの FTIR ガス分析計 FT-730および専用ガスセルを用いてガススペクトルを測定した。 図2に原料の化学構造を,図3に測定状況,表2に測定 条件をそれぞれ示す。



図2 測定試料と分子構造



図3 ホリバの FTIR とガスセル

#### −般論文

FTIR	Resolution	4cm <sup>-1</sup>
measurement	Measurement time	90s
condition	Detector	TGS
Gas cell	Optical path length	0.1m
condition	Body material	SUS316
	Window material	KRS-5
	Temperature	25 ~ 140°C
Vaporization	Directly vaporized in gas cell	

表2 測定条件

### 4 測定結果

4.1 単成分の吸収スペクトル

3種類の原料それぞれを気化させたときの吸収スペクト ルを図4に示す。スペクトル中のとくに低波数域に金属 酸素結合に由来するピークが見られる。これは,それぞれ のピークに着目することにより,物質の識別が可能である ことを示す。



図4 各原料の赤外吸収スペクトル

#### 4.2 混合ガスのスペクトル

CVDチャンバーへは混合状態で原料が投入されるため, 次にその予備試験として混合状態を計測した。

図5はZr原料とTi原料を混合させた状態のスペクトル を示す。図中,2段目のスペクトルが混合状態である。上 段および中段の単成分状態と比較すると,混合によって消 失するピークや,中心波数がシフトするピークが観察され る。これは,混合状態においてそれぞれ単独で存在するの ではなく,分子の結合状態も変化していることを示唆して いる。



図5 Zr および Ti 原料の混合時の赤外スペクトル

さらに,Pb原料をさきの2成分に添加した後の赤外スペク トルを図6に示す。3成分が混合することにより,単成分の スペクトルとは様子が大きく異なることを表している。すな わち,原料が混合されることにより,成膜前にすでにPZTの 中間体が形成され,その状態でCVDチャンバー内で強誘電 体PZT膜として堆積されているものと推察される。



図6 Pb,Zr および Ti 原料の混合時の赤外スペクトル

# 5 今後の展開

FRAMの実用化にあたり,短期的な視野に立って考える と,PZTは製膜温度の点でSBTに比べて有利だと言われて いる。一方,素子特性の点からはビスマス酸タンタル酸ス トロンチウム(SBT)が長期的には台頭してくるものと思わ れる。

これらの技術動向を考慮して,今後の計測器の課題としては次のようにをまとめられる。

SBT 系原料に対しても計測のできる高温対応ガスセルの開発

新規開発原料への迅速な対応

生産装置への組み込みを想定したFTIRの小型化および 堅牢化

濃度のキャリブレーションシステム開発3)

# 6 おわりに

強誘電体薄膜のPZTに着目し,MOCVD装置に供給され る原料の混合状態をFTIRにより計測し,原料が中間体を 形成していることを推察できるデータを得た。これは,成 膜法の開発において最も重要な膜の組成制御に対して<sup>4)</sup>, 新しいパラメータを提案できるものと考えられる。

また FTIR は,その分光測定能力の高さを生かして半導体生産装置に組み込まれることにより,生産プロセスの制御センサとして活躍する場があることを確信している。

## 参考文献

 P.R.Griffiths, J.A.de Haseth, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, John Wiley, New York (1986)

2) 舟窪, 佐竹 第61 回応用物理学会学術講演会

講演予稿集 5p-G-9(2000)

3) 佐竹:特許出願中

4 )H.Funakubo et al. J.Chemical Vapor Deposition, Vol.2 Jan P.218 (1994)



佐竹 司

Tsukasa SATAKE 半導体システム開発部 マネージャー